附件

**2025中国汽车芯片创新成果**

**申报书**

申报企业：

申报芯片型号：

2025年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、企业基本情况表** | | | | | | | | |
| 企业名称 |  | | | | 所在城市 | | |  |
| 通讯地址 |  | | | | 邮编 | | |  |
| 法定代表人 |  | 电话 | |  | 手机 | | |  |
| 联系人 |  | 电话 | |  | 手机 | | |  |
| E-mail |  | | | | | | | |
| 注册时间 |  | | | 注册资本（万元） | | |  | |
| 企业注册地 |  | | | | | | | |
| 2024年营收（万元） |  | | 2024年研发占营收比例（%） | | |  | | |
| 企业类型 | 🞏 国有 🞏 中外合资 🞏 民营 🞏外商独资  🞎 其他： | | | | | | | |
| 企业简介 |  | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **二、申报芯片情况表** | |
| 申报芯片类别  （仅勾选一类） | 🞎 控制类 🞏 模拟类 🞏 电源类 🞏 驱动类  🞎 存储类 🞏 传感器类 🞏 功率类 🞏 通信类  🞏 信息安全类 🞎 计算类 🞏 其他： |
| 芯片型号 |  |
| 主要技术参数 | 包括不限于：  1.本款芯片主要技术参数；  2.横向对比国内外同类产品。  备注：提供相关证明材料与文字说明（客观、可量化内容），不超过500字。 |
| 供货稳定  情况说明 | 1.制造地区：🞎 在大陆流片 🞎其他地区流片：  2.封装地区：🞎 在大陆封装 🞎其他地区封装：  3.供货稳定现状证明：  备注：提供相关证明材料与文字说明（客观、可量化内容），不超过100字。 |
| 上车应用  情况说明 | 1.上车应用情况：🞎 已上车应用 🞎 未上车应用  2.上车应用数量：🞎 10万片以上 🞎 其他数量：  3.搭载该款芯片的车辆情况：  备注：提供相关证明材料与文字说明（客观、可量化内容），不超过100字。 |
| 创新能力及  应用前景 | 填写说明（包括不限于）：   1. 对标国内外同类型芯片的情况； 2. 攻克的技术难点； 3. 自有知识产权情况说明，包括不限于涉及该款芯片型的IP数量及占比（自研IP数量、授权IP数量以及自研IP数量占总IP数量百分比）、专利数量等； 4. 本款芯片的关键核心技术研发团队是否在境内； 5. 本款芯片社会与经济效益； 6. 本款芯片应用前景等方面。   备注：提供相关证明材料与文字说明（客观、可量化内容），不超过3000字。 |
| 真实性声明 | 以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息，不存在知识产权侵权行为，本企业愿为此承担有关法律责任。  法定代表人/授权代表（签名）： （企业公章）：    日期：2025年 月 日 |
| 备注：  1.企业可申报多款芯片，但每个类别的芯片仅可申报1款型号（同系列产品只报1款）；  2.“二、申报芯片情况表”可重复添加（1款芯片填写1张表格）。 | |